

中国IC封装基板行业重点企业发展预测及投资前景分析报告(2026-2031版)

报告简介

封装基板是芯片封装体的重要组成材料，主要起承载保护芯片与连接上层芯片和下层电路板作用。

完整的芯片由裸芯片(晶圆片)与封装体(封装基板及固封材料、引线等)组合而成。

封装基板作为芯片封装的核心材料，一方面能够保护、固定、支撑芯片，增强芯片导热散热性能，保证芯片不受物理损坏，另一方面封装基板的上层与芯片相连，下层和印刷电路板相连，以实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以及沟通芯片内部与外部电路等功能。

随着国内封装基板产业升级，本土封装基板需求将迅速提升。2019年国内封装基板市场规模达103亿元，占封装材料比重接近32%，远远低于全球50%的占比。

从全球封装基板制造企业类型来看，主要可分三大部分：1)由封测厂商投建的IC封装基板生产厂，如日月光等企业;2)由PCB厂商拓展业务至封装基板，封装基板与PCB中的HDI板在制造工艺上存在一定共通之处，属于技术同源，比如我国深南电路;3)专门生产封装基板的厂商，包括信泰电子等。从主要封装基板厂商企业类型看，当前PCB厂占据行业主流。作为集成电路产业链中的关键配套材料，中国大陆封装基板的全球占有率仅为1.23%，国产封装基板占比更少，可见国产替代空间较大。

全球封装基板的主要生产商集中于我国台湾、韩国和日本三地，全球前十大封装基板厂商占据80%以上的份额，行业呈现寡头垄断格局。目前全球封装基板前十厂商均来自日本、韩国及中国台湾三地。

我国封测产业地位的加强，半导体自产能力的提升以及国家对于半导体关键零部件和耗材国产化的推进，都将加速封装基板的国产化替代。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、51行业报告网、

全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国IC封装基板市场进行了分析研究。报告在总结中国IC封装基板行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国IC封装基板行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为IC封装基板企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章 ic封装基板产业相关概述 1

第一节 ic封装基板简介 1

一、ic封装基板产业概述 1

二、ic封装基板特性 2

第二节 2021-2026年世界主要国家ic封装基板产业分析 3

一、美国 3

二、印度 3

三、澳大利亚 4

四、日本 4

第三节 2026-2031年世界ic封装基板产业发展趋势分析 4

第二章 2021-2026年中国ic封装基板产业运行环境分析 6

第一节 2021-2026年中国宏观经济环境分析 6

一、中国gdp分析 6

二、消费价格指数分析 7

三、城乡居民收入分析 12

四、社会消费品零售总额 14

五、全社会固定资产投资分析 15

六、进出口总额及增长率分析 17

第二节 2021-2026年中国ic封装基板产业政策环境分析 21

一、ic封装基板产业政策解读 21

二、ic封装基板产业振兴规划 29

三、ic封装基板产业进出口政策分析 58

第三章 2021-2026年中国ic封装基板市场供需调查分析 59

第一节 2021-2026年中国ic封装基板市场供给分析 59

一、产品市场供给 59

二、影响供给的因素分析 60

第二节 2021-2026年中国ic封装基板市场需求分析 60

一、产品市场需求 60

二、影响需求的因素分析 61

第三节 2021-2026年中国ic封装基板产业发展存在问题分析 61

第四章 2021-2026年中国ic封装基板产品市场进出口数据分析 62

第一节 2021-2026年中国ic封装基板产品出口统计 62

第二节 2021-2026年中国ic封装基板产品进口统计 62

第三节 2021-2026年中国ic封装基板产品进出口价格对比 62

第四节 中国ic封装基板产品进口主要来源地及出口目的地 63

第五章 2021-2026年中国ic封装基板产量统计分析 65

第一节 2021-2026年全国ic封装基板产量分析 65

第二节 2021-2026年全国及主要省份ic封装基板产量分析 65

第三节 2021-2026年ic封装基板产量集中度分析 66

第六章 2021-2026年中国ic封装基板产业主要数据监测分析 67

第一节 2021-2026年中国ic封装基板行业规模分析 67

一、企业数量增长分析 67

二、从业人数增长分析 67

三、资产规模增长分析 67

第二节 2021-2026年中国ic封装基板行业结构分析 68

一、企业数量结构分析 68

二、销售收入结构分析 68

第三节 2021-2026年中国ic封装基板行业产值分析 68

一、产成品增长分析 68

二、工业销售产值分析 68

第四节 2021-2026年中国ic封装基板行业成本费用分析 69

一、销售成本分析 69

二、费用分析 69

第五节 2021-2026年中国ic封装基板行业盈利能力分析 69

一、主要盈利指标分析 69

二、主要盈利能力指标分析 69

第七章 2021-2026年世界ic封装基板重点厂商分析 71

第一节 京瓷集团 71

一、企业概况 71

二、ic封装基板市场竞争力分析 72

三、在华发展战略 72

第二节 三星机电 73

一、企业概况 73

二、ic封装基板市场竞争力分析 74

三、在华发展战略 74

第三节 神户电机 74

一、企业概况 74

二、ic封装基板市场竞争力分析 74

三、在华发展战略 75

第八章 中国ic封装基板产业重点企业竞争性财务数据分析 76

第一节 深南电路股份有限公司 76

一、企业概况 76

二、企业主要经济指标分析 77

三、企业盈利能力分析 77

四、企业偿债能力分析 78

五、企业运营能力分析 78

六、企业成长能力分析 79

第二节 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 79

一、企业概况 79

二、企业主要经济指标分析 80

三、企业盈利能力分析 80

四、企业偿债能力分析 81

五、企业运营能力分析 81

六、企业成长能力分析 82

第三节 珠海越亚半导体股份有限公司 82

一、企业概况 82

二、企业经营情况 82

三、企业产品技术分析 83

四、企业发展历程 83

第四节 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 84

一、企业概况 84

二、企业主要经济指标分析 84

三、企业盈利能力分析 85

四、企业偿债能力分析 85

五、企业运营能力分析 86

六、企业成长能力分析 86

第五节 株洲中车时代电气股份有限公司 87

一、企业概况 87

二、企业主要经济指标分析 87

三、企业盈利能力分析 87

四、企业偿债能力分析 88

五、企业运营能力分析 88

六、企业成长能力分析 88

第九章 2026-2031年中国ic封装基板市场投资潜力及前景预测 89

第一节 2026-2031年中国ic封装基板市场未来发展趋势 89

一、中国ic封装基板行业发展趋势 89

二、ic封装基板产品技术的发展走向 89

三、ic封装基板行业未来发展方向 90

第二节 2026-2031年中国ic封装基板市场前景展望 90

一、中国ic封装基板市场发展前景 90

二、未来国家政策规划 90

三、2026-2031年中国ic封装基板市场规模预测 99

第十章 结论及建议 100

附录一 国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知 101

附录二 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 108

图表目录

图表：全球主要ic封装基板厂商 2

图表：2021-2026年美国ic封装基板产业分析 3

图表：2021-2026年印度ic封装产业市场规模及世界占比 4

图表：2021-2026年国内生产总值和增长速度(单位：亿元，%) 6

图表：制造业pmi指数(经季节调整) 7

图表：中国制造业pmi及构成指数(经季节调整) 8

图表：中国制造业pmi其他相关指标情况(经季节调整) 9

图表：非制造业商务活动指数(经季度调整) 9

图表：中国非制造业主要分类指数(经季节调整) 11

图表：中国非制造业其他分类指数(经季节调整) 11

图表：综合pmi产出指数(经季度调整) 12

图表：2021-2026年全国居民人均可支配收入及其增长速度(单位：元，%) 13

图表：2021-2026年全国居民人均消费支出及其构成 13

图表：2021-2026年中国社会消费品零售结构 15

图表：2021-2026年三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重 16

图表：2021-2026年分行业固定资产投资(不含农户)增长速度 16

图表：2021-2026年固定资产投资新增主要生产与运营能力 17

图表：2021-2026年房地产开发和销售主要指标及其增长速度 17

图表：2021-2026年货物进出口总额(单位：亿元) 18

图表：2021-2026年货物进出口总额及其增长速度 18

图表：2021-2026年主要商品出口数量、金额及其增长速度 19

图表：2021-2026年主要商品进口数量、金额及其增长速度 19

图表：2021-2026年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重 20

图表：2021-2026年外商直接投资(不含银行、证券、保险领域)及其增长速度 20

图表：2021-2026年对外非金融类直接投资额及其增长速度 21

图表：2021-2026年中国ic封装基板市场供给规模 59

图表：2021-2026年中国市场供给品牌来源 59

图表：2021-2026年产品市场需求 60

图表：2021-2026年封装基板出口统计 62

图表：2021-2026年封装基板进口统计 62

图表：2021-2026年中国ic封装基板产品进出口价格对比 62

图表：2021-2026年出口目的地分析 63

图表：全国ic封装基板项目分布	65
图表：2021-2026年主要省份ic封装基板产量	66
图表：2021-2026年封装基板产量集中度分析	66
图表：2021-2026年企业数量情况	67
图表：2021-2026年从业人数情况	67
图表：2021-2026年从业资产规模情况	68
图表：2021-2026年工业销售产值	68
图表：2021-2026年销售费用率	69
图表：2021-2026年中国ic封装基板行业盈利分析	69
图表：2021-2026年主要盈利能力分析	69
图表：2021-2026年深南电路主要经济指标	77
图表：2021-2026年企业盈利能力分析	77
图表：2021-2026年企业偿债能力分析	78
图表：2021-2026年企业运营能力分析	78
图表：2021-2026年企业成长能力分析	79
图表：2021-2026年兴森科技主要经济指标分析	80
图表：2021-2026年企业盈利能力分析	80
图表：2021-2026年企业偿债能力分析	81
图表：2021-2026年企业运营能力分析	81
图表：2021-2026年企业运营能力分析	82
图表：越亚股份发展历程	83
图表：鹏鼎控股2021-2026年主要经济指标	84

图表：鹏鼎控股2021-2026年盈利能力分析 85

图表：鹏鼎控股2021-2026年偿债能力分析 85

图表：鹏鼎控股2021-2026年运营能力分析 86

图表：鹏鼎控股2021-2026年成长能力分析 86

图表：2021-2026年株洲中车时代主要经济指标 87

图表：2021-2026年株洲中车时代盈利能力分析 87

图表：2021-2026年株洲中车时代偿债能力分析 88

图表：2021-2026年株洲中车时代运营能力分析 88

图表：2021-2026年株洲中车时代成长能力分析 88

图表：使用无芯封装基板的索尼cell处理器 90

图表：2026-2031年中国ic封装基板市场规模预测(亿元) 99

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：182015

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20200910/182015.shtml>

在线订购：[点击这里](#)